

デンカアルシンク DENKA ALSINK

軽量・高信頼性ベース板
Light and high reliable base plate

ANP・SNP(セラミックス基板)との相性抜群
Well compatible with ANP and SNP (ceramics substrate)



■ 特長

- 反り対策:ご要望に合わせて反り仕様を柔軟にカスタマイズ。
- 軽量:重さが銅のベース板と比べ約1/3。
- 高信頼性:ヒートサイクル特性抜群。熱膨張率がセラミックス基板に近いので、半田クラックを抑制します。
- 実績:電鉄分野で高い市場シェアを獲得しており、信頼性が求められる部品に欠かせない製品です。

■ Properties

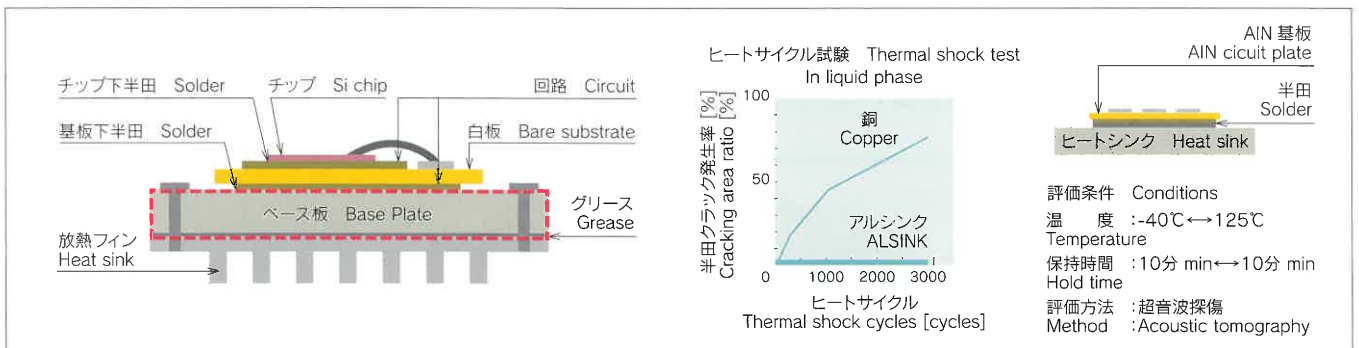
- Bow:Customize flexibly.
- Light :Approximate 1/3 weight of copper base plate.
- High reliability:Solder cracks can be reduced because coefficient of thermal expansion is close to ceramics.
- Achievement:High share in traction field. Essential parts for high reliability.

■ 物性値 / Properties

代表特性 Typical properties	アルシンク ALSINK	Cu	Cu-85Mo
熱伝導率 (W/mK) Thermal conductivity	200	390	160
線膨張係数 (ppm/K) Coefficient of thermal expansion	7.5	16.6	7
抗折強度 (MPa) Bending strength	400	—	—
破壊靱性 (Mpa・m ^{1/2}) Fracture toughness	8	—	—
密度 (g/cm ³) Density	2.96	8.96	10.1
比熱 (J/g・K) Specific heat (20℃)	0.75	—	—

※厚み 3~5mm(標準 5mm) ※Thickness 3~5mm(standard 5mm)

■ パワートランジスタ・モジュール組立図 / Structure of power transistor module



ALSINK は電鉄をはじめとする様々な大容量(インバーター)モジュールに多く活用されています。
ALSINK is used for various purposes including traction.

■ 用途 / Applications

